



品番 PRODUCT No.	A	B	C
SMD25-26WL	35.56	30.48	12.7
SMD25-28WL	38.10	33.02	10.2
SMD25-30WL	40.64	35.56	12.7

④					②	黄銅 Brass	△△ 半田鍍金又は錫鍍金 <del>Solder Plating or Tin Plating</del>
③				SMD25-□□WL	①	ナイロン66 (GFA) NYLON66 (GF)	UL94 V-0
△	04.12.8	半田メッキ削除 Solder Plating deletion.	N. Y. H.	製品番号 PRODUCT No.	No.	材 料 MATERIAL	備 考 NOTE
△	03.2.20	角ピンメッキ追加 Pin Plating addition.	K. K. Y. H.				
記号 No.	年月日 DATE	変更記事 REVISION RECORD	設計 承認 DESIGN APP			製品名 SMDウエハー (アングル型) NAME SMD WAFER (L-Type)	
承認 APPROVED	確認 CHECKED			一般公差 TOLERANCE	尺度 SCALE	図番 DRAWING No. JC-0807-11E	
K. Shiine	Y. Horiuchi			±0.3	2 / 1		
設計 DESIGN	製図 DRAWING			JAPAN AUTOMATIC MACHINE CO., LTD.			
K. Kusano	K. Kusano						